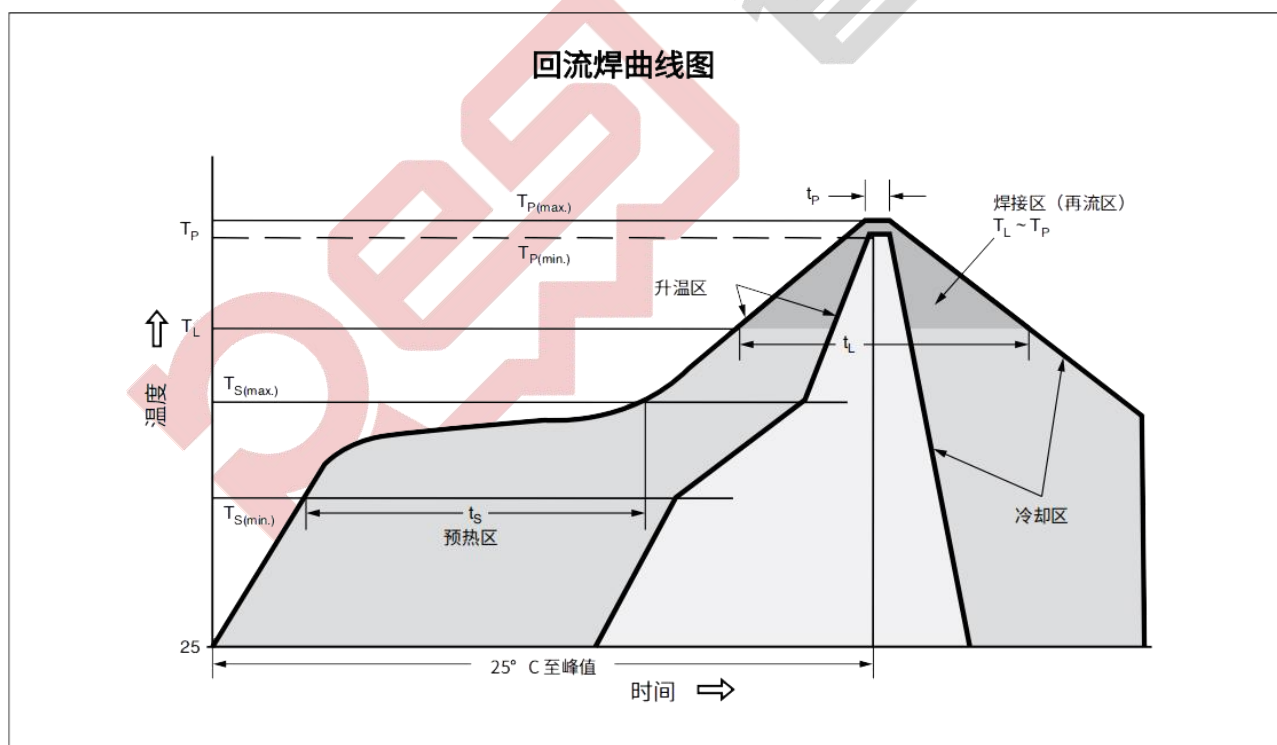


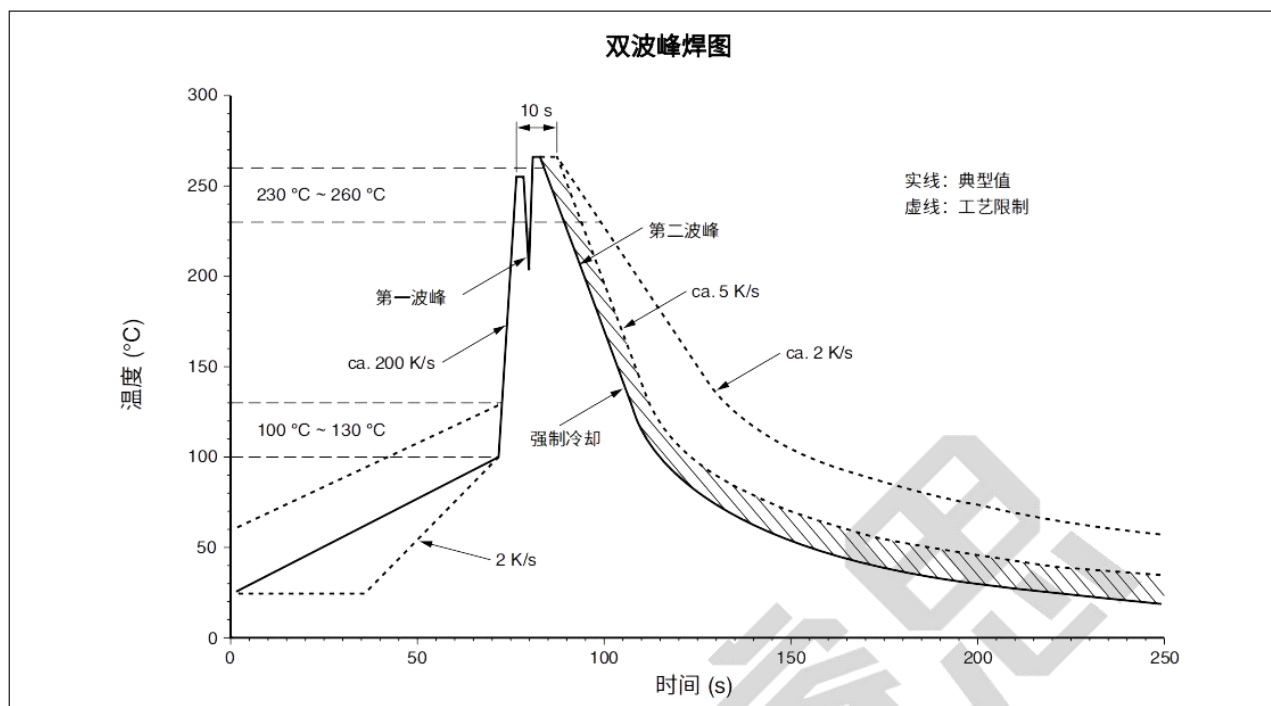
箔电阻焊接建议

一般来说，行业内用于电阻器的所有标准安装方法和溶剂清洗剂也适用于 Bulk Metal® 箔电阻。通常情况下，用户会采用最适合自己的方法和工艺，同时也考虑到类型、制造商关于焊接测试的建议、印刷电路板上元件的距离、设备等因素。同样的标准也适用于无铅引脚，这些标准应与无铅焊料相关。电镀合金的共晶温度决定了最低的焊接工艺温度。最低焊接温度范围应至少比电镀合金的共晶温度高 5 °C 至 10 °C（根据技术文献）。器件必须在峰值焊接温度下保持足够长的时间，以确保焊接连接处的适当的润湿。不过，建议将峰值焊接时间保持在最短时间，以避免损坏器件的可能性（根据技术文献）。



推荐的回流焊参数

不同焊料的回流焊参数		
参数	有铅焊料 (Sn – Pb)	无铅焊料 (如SnAgCu)
平均升温速率($T_{S(max.)}$ to T_P)	最大值3°C/s	
预热		
• 最低温度 ($T_{S(min.)}$)	100°C	150°C
• 最高温度 ($T_{S(max.)}$)	150°C	200°C
• 时间 ($T_{S(min.)}$ to $T_{S(max.)}$) (t_S)	60 s ~ 120 s	60 s ~ 180 s
维持在温度以上的时间		
• 最低温度 (T_L)	183°C	217
• 时间 (T_L)	60 s ~ 150 s	60 s ~ 150 s
最低峰值温度 ($T_{P(min.)}$)	215°C	235°C
推荐峰值温度 (T_P)	235°C	250°C
最高峰值温度 ($T_{P(max.)}$)	260°C	260°C
实际峰值温度, 5°C 以内的时间 (t_p)	10 s to 40 s	20 s to 40 s
冷却速率	最大值 6°C/s	最大值 6°C/s
25°C 至峰值温度的时间	至多 6 分钟	至多 8 分钟



声明

- 本文件仅供参考。其他参数也可能影响焊接，因此这些曲线不能保证绝对的焊接成功。
- 焊接曲线应由焊料制造商确定，但不应与本文中的建议相矛盾。